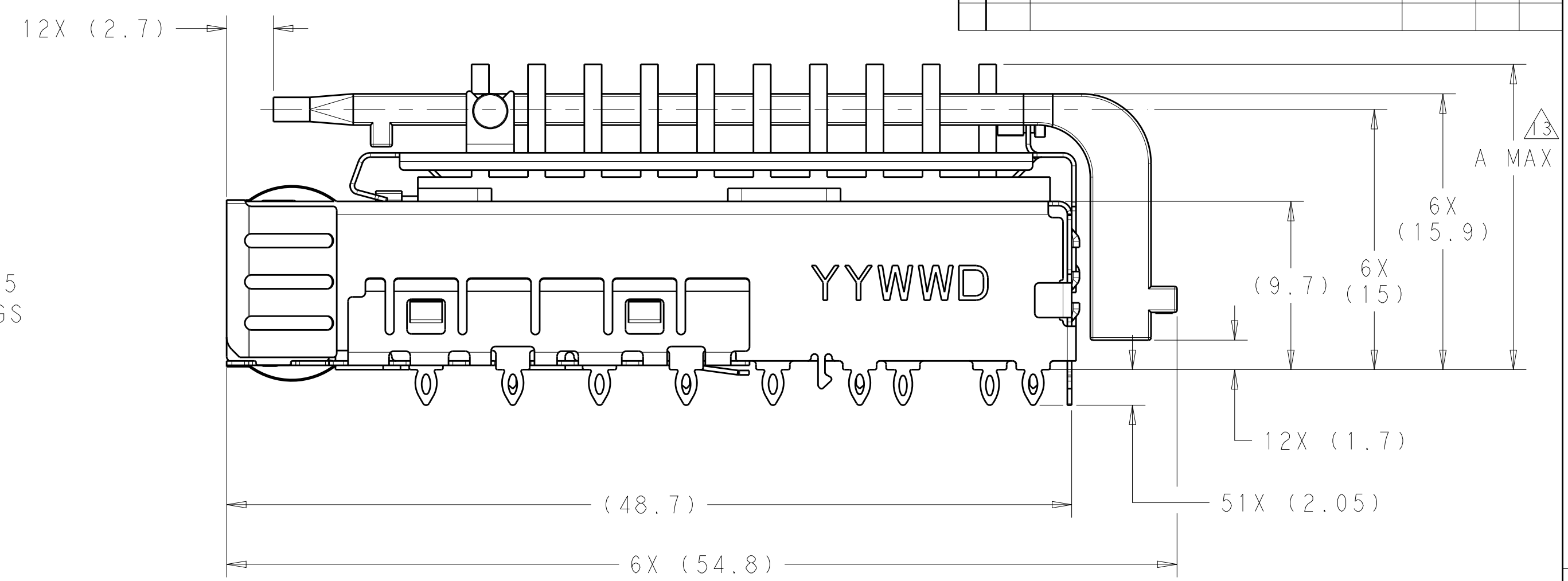
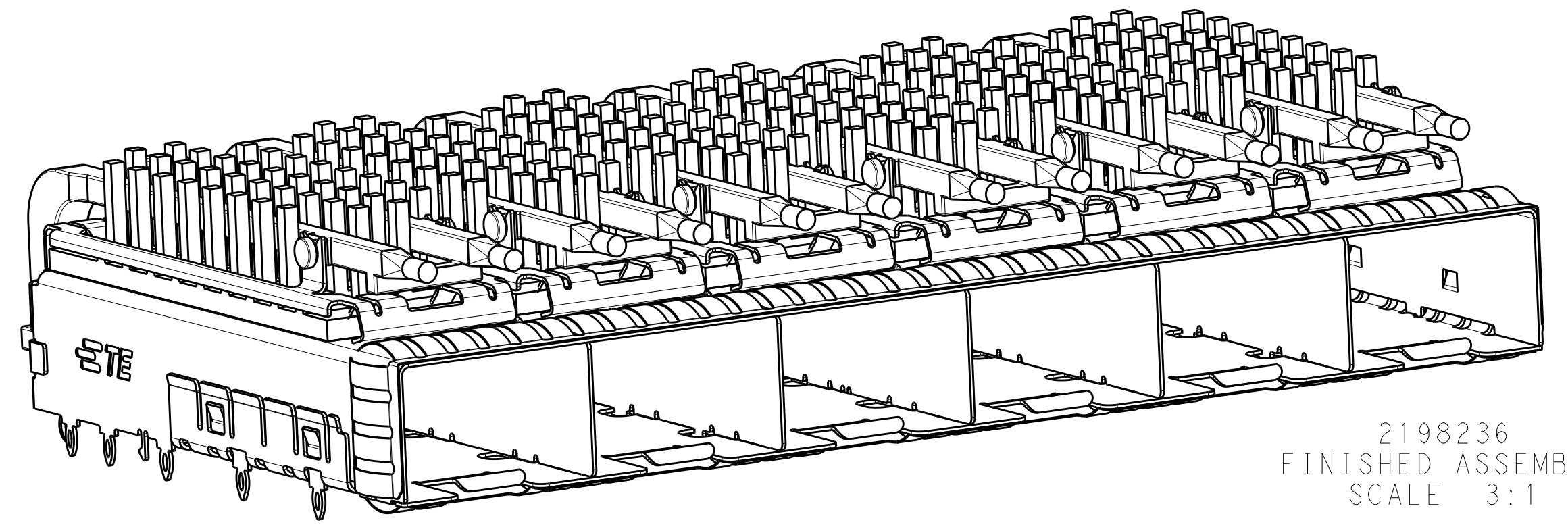
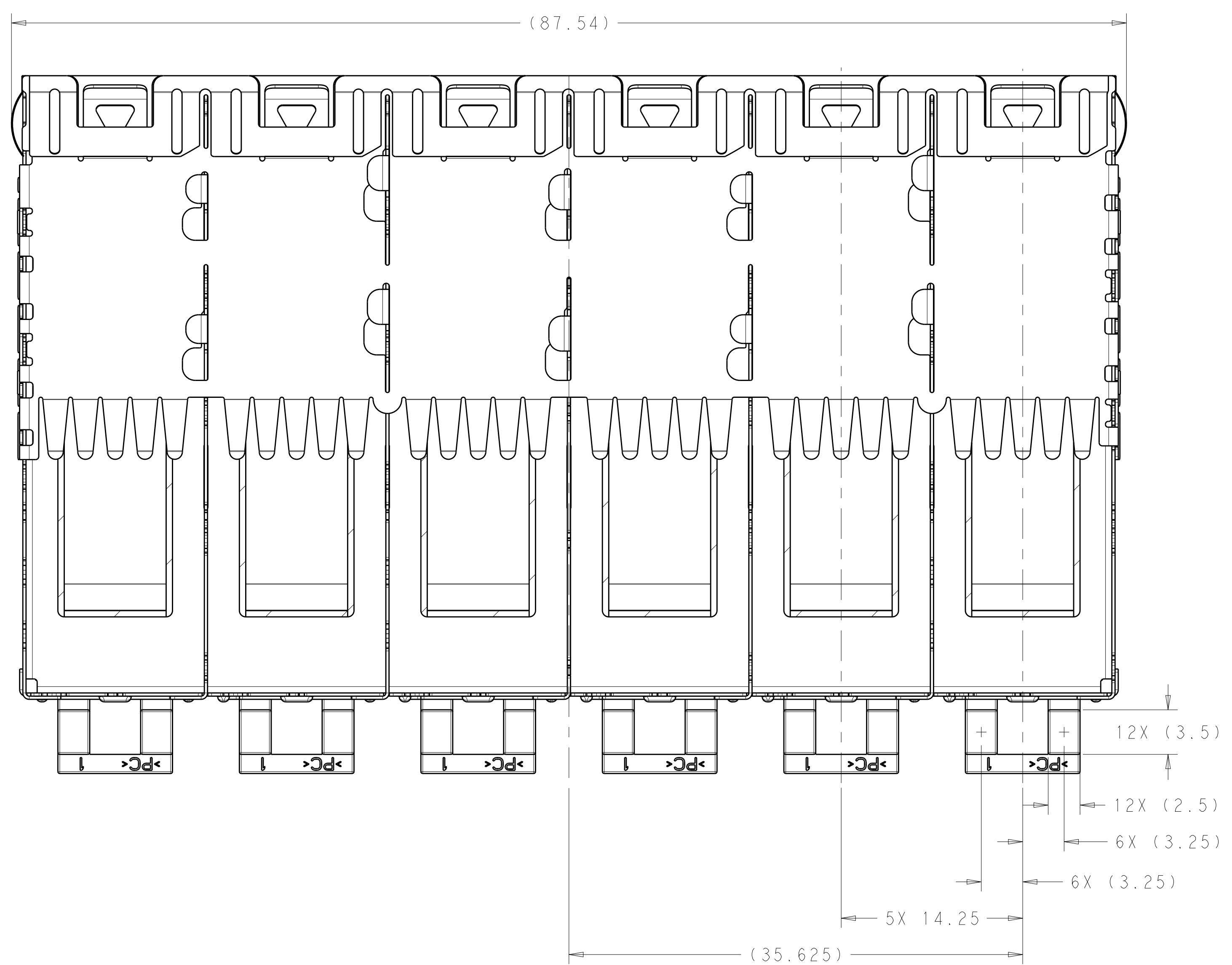
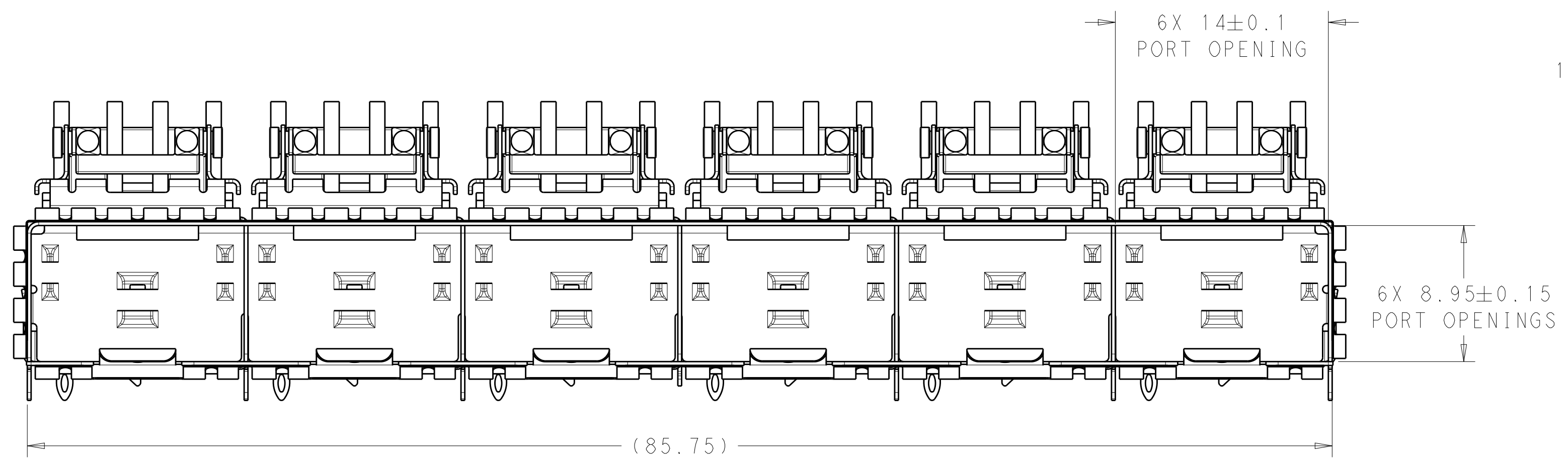


LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTN	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		A		RELEASED PER ECO-12-013192	18OCT2012	BMM	MRS



- 1 MATERIAL:
CAGE ASSEMBLY: 0.25mm THICK NICKEL SILVER ALLOY.
HEATSINK/LIGHTPIPE CLIP: STAINLESS STEEL
LIGHT PIPE: POLYCARBONATE, CLEAR
HEATSINK: ALUMINUM
- 2 FINISH:
SPRINGS: MINIMUM OF 0.8um TIN PLATE OVER A MINIMUM OF 0.8um NICKEL UNDERPLATE.
NON-PLATED EDGES PERMISSIBLE.
HEATSINK/LIGHTPIPE CLIP: PASSIVATE
HEATSINK: ELECTROLESS NICKEL
- 3. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT TRANSCEIVERS.
- 4 PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.
- 5. INTERPRETATION OF DATUM REFERENCE FRAME IN ACCORDANCE WITH SECT 4.4.1.1 OF ASME Y14.5M-1994.
- 6 MINIMUM PC BOARD THICKNESS:
SINGLE SIDED = 1.50mm
DOUBLE SIDED = 2.25mm
- 7 HOLE PATTERN REPEATS FOR EACH PORT. SPACING BETWEEN PORTS IS 14.25mm.
- 8 DATUM AND BASIC DIMENSION ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 9 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
- 10 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE B, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
- 11. CERTAIN MATING TRANSCEIVERS MAY REQUIRE ADDITIONAL PCB THICKNESS THAT WOULD BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.
- 12. PRODUCT COMPLIES WITH SPECIFICATION SFF-8433 IMPROVED PLUGGABLE FORM FACTOR FOR SFP+ GANGED CAGES.
- 13 DIMENSION APPLIES PRIOR TO INSERTION OF SFP MODULE
- 14 HEATSINK, HEATSINK CLIP, AND LIGHTPIPE SHIPPED UNASSEMBLED TO CAGE ASSEMBLY. CAGE ASSEMBLY TO BE PRESSED INTO PCB PRIOR TO ATTACHING HEATSINK, HEATSINK CLIP, AND LIGHTPIPE TO THE CAGE ASSEMBLY.
- 15 PACKAGED AS A COMPLETE ASSEMBLY.

22.5	NETWORKING, TALL	2198236-4
18.1	NETWORKING, SHORT	2198236-3
15.5	SAN	2198236-2
13.2	PCI	2198236-1
A MAX	APPLICATION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN: B. MATTHEWS 15NOV2011
CHK: M. SCHMITT 15NOV2011
APVD: M. SCHMITT 15NOV2011

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±0.1
1 PLC ±0.1
2 PLC ±0.1
3 PLC ±0.1
4 PLC ±0.1
ANGLES ±0.1

MATERIAL:

FINISH:

Customer Drawing

NAME: SFP+ ENHANCED 1X6 CAGE ASSEMBLY, PRESS FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS WITH HEATSINK AND LIGHTPIPE

PRODUCT SPEC: 108-2364

APPLICATION SPEC: 114-13120

SIZE: A1

CAGE CODE: 00779

DRAWING NO: 2198236

RESTRICTED TO:

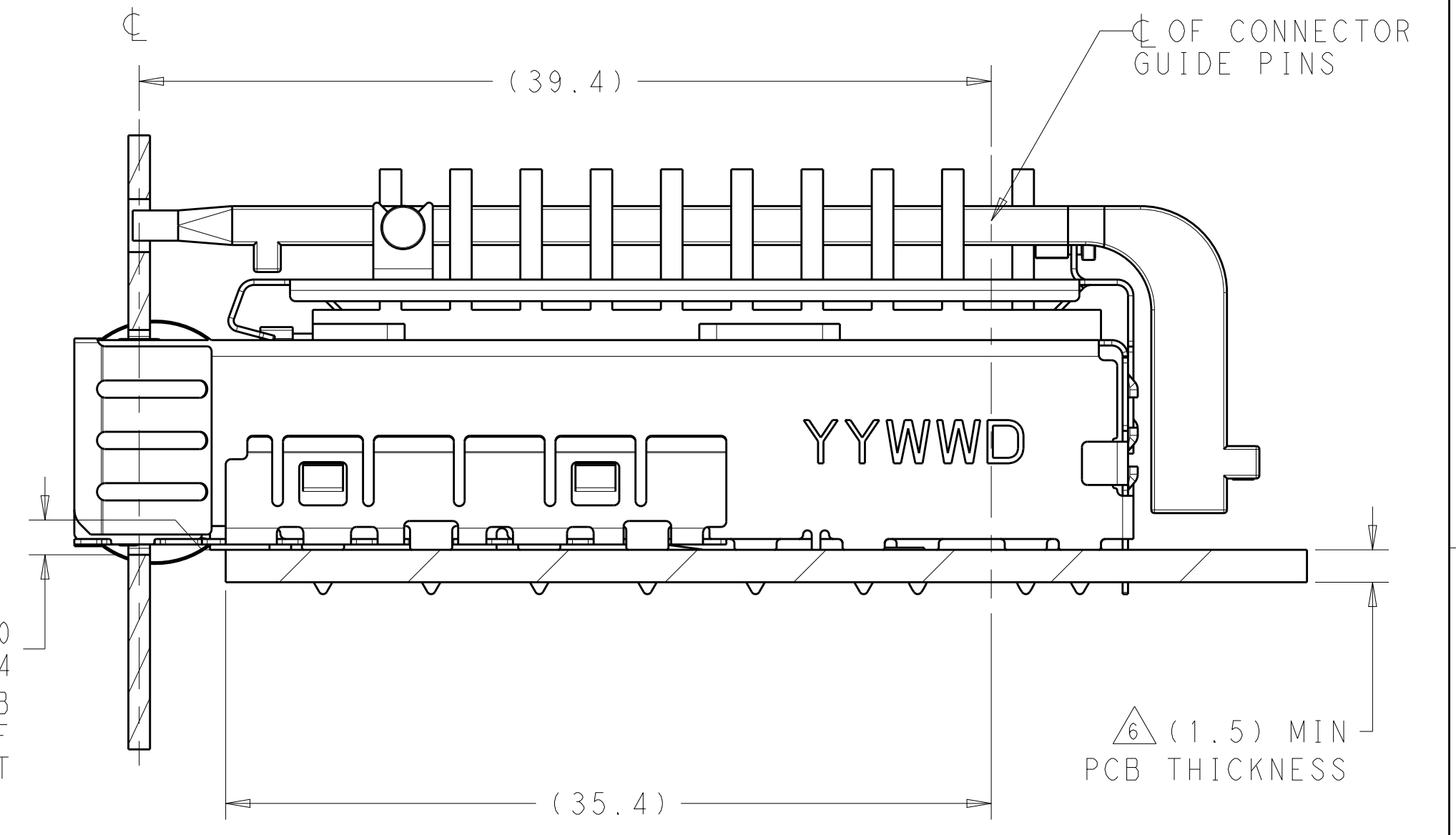
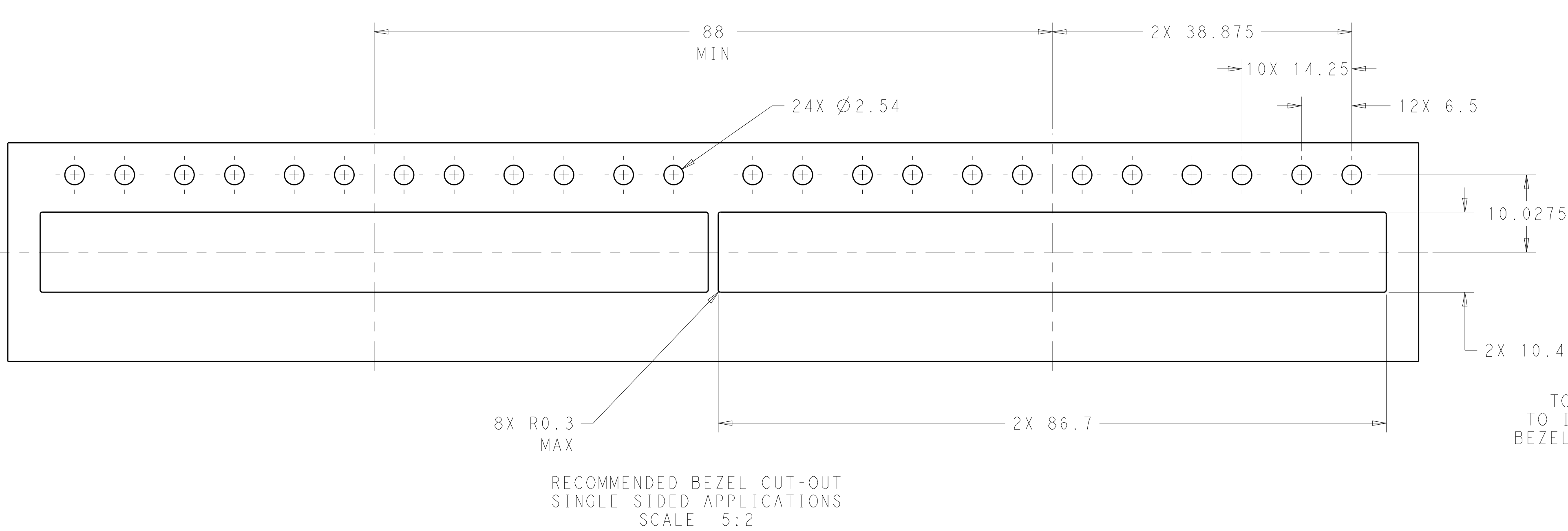
SCALE: 4:1

SHEET: 1 OF 4

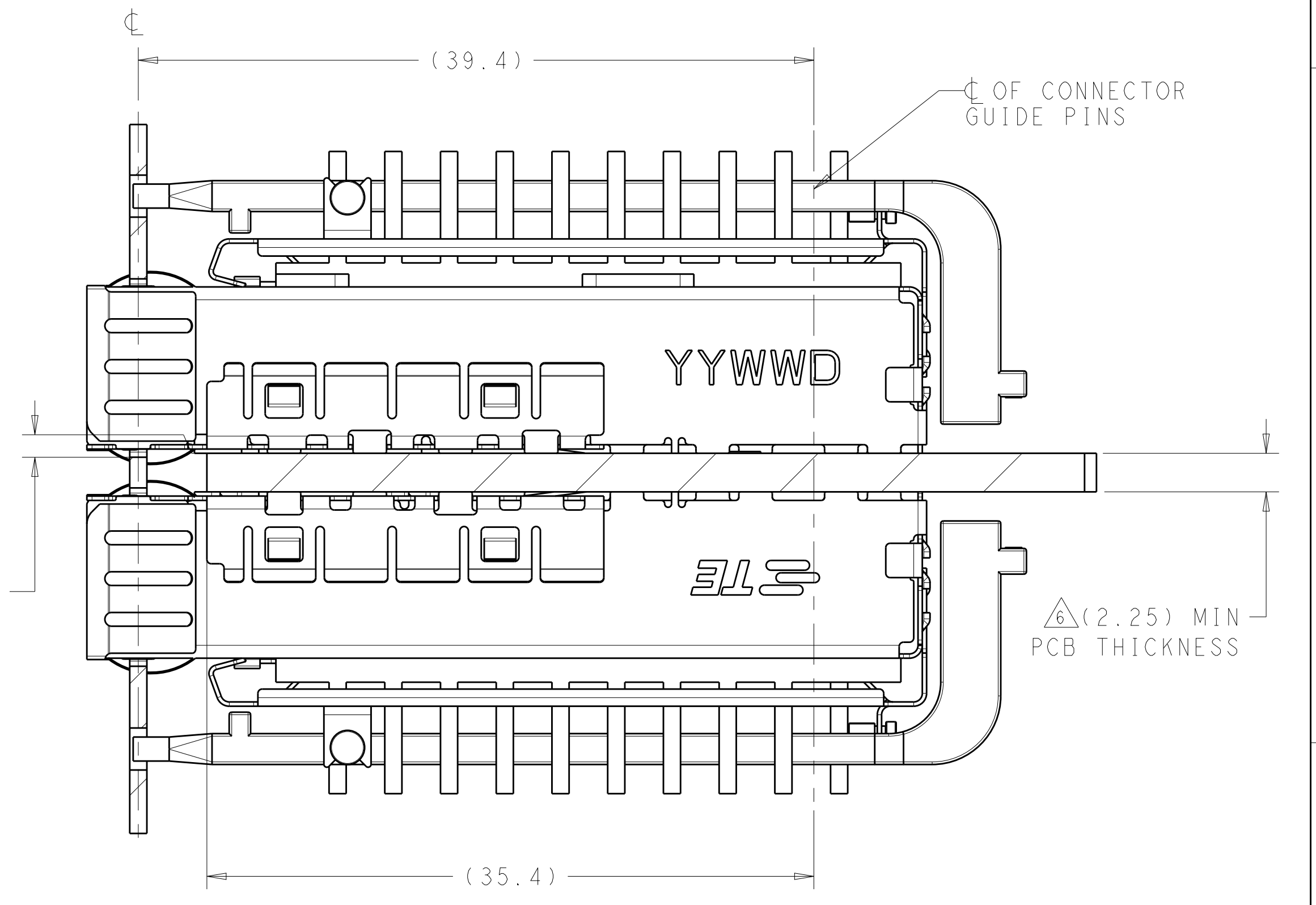
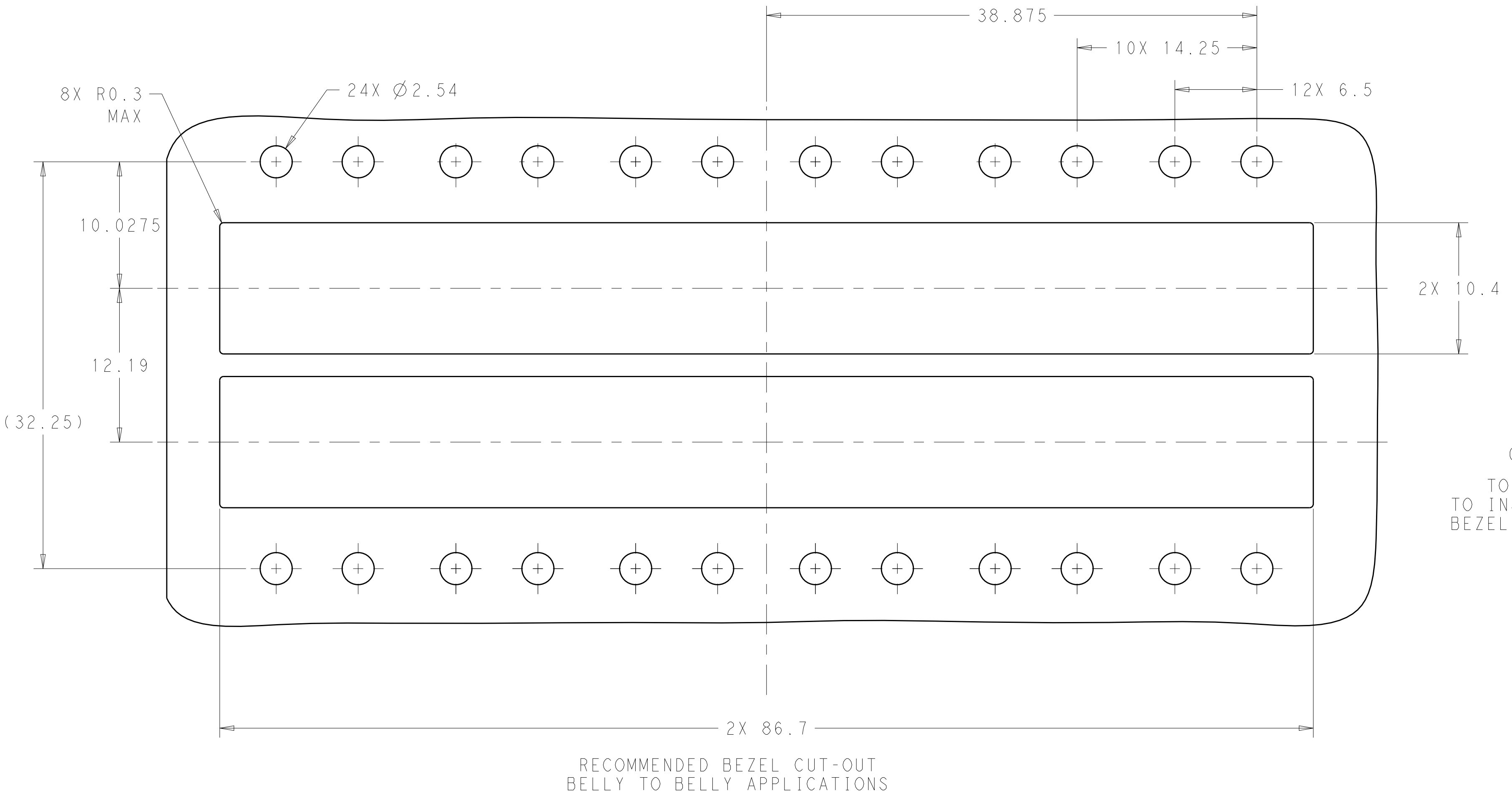
REV: A

LOC	DIST	REV	DATE	BY	APPV
GP	00				

REVISIONS			
NO.	DESCRIPTION	DATE	BY
-	SEE SHEET 1	-	-



2198236 MOUNTED ON PC BOARD SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL

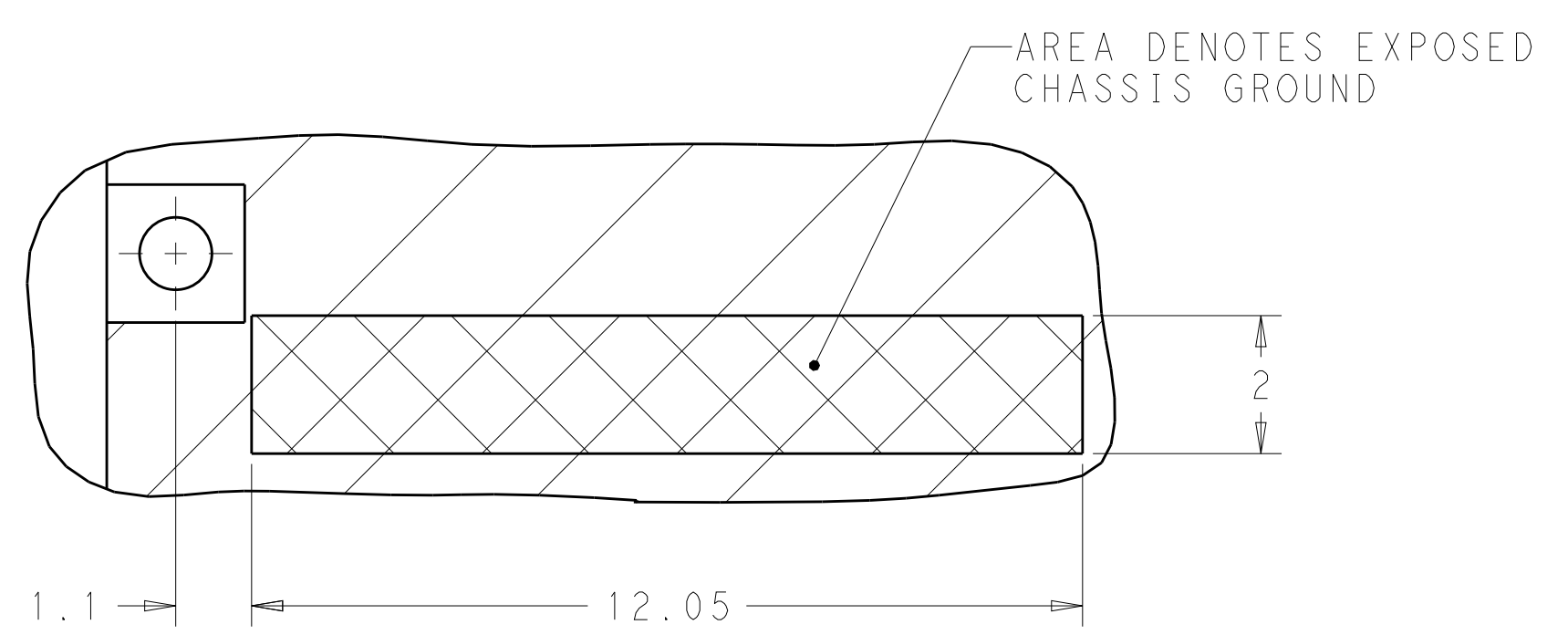


2198236 MOUNTED BELLY TO BELLY ON PC BOARD SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: B. MATTHEWS 15NOV2011	 TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		CHK: M. SCHMITT 15NOV2011	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD: M. SCHMITT 15NOV2011	NAME: SFP+ ENHANCED 1X6 CAGE ASSEMBLY, PRESS FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS WITH HEATSINK AND LIGHTPIPE PRODUCT SPEC: 108-2364 APPLICATION SPEC: 114-13120 WEIGHT: - Customer Drawing
0 PLC ±0.1 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.1 3 PLC ±0.1 4 PLC ±0.1 ANGLES ±1°		SIZE: 114-13120 CAGE CODE: - DRAWING NO: 2198236 SCALE: 4:1 SHEET: 2 OF 4 REV: A	

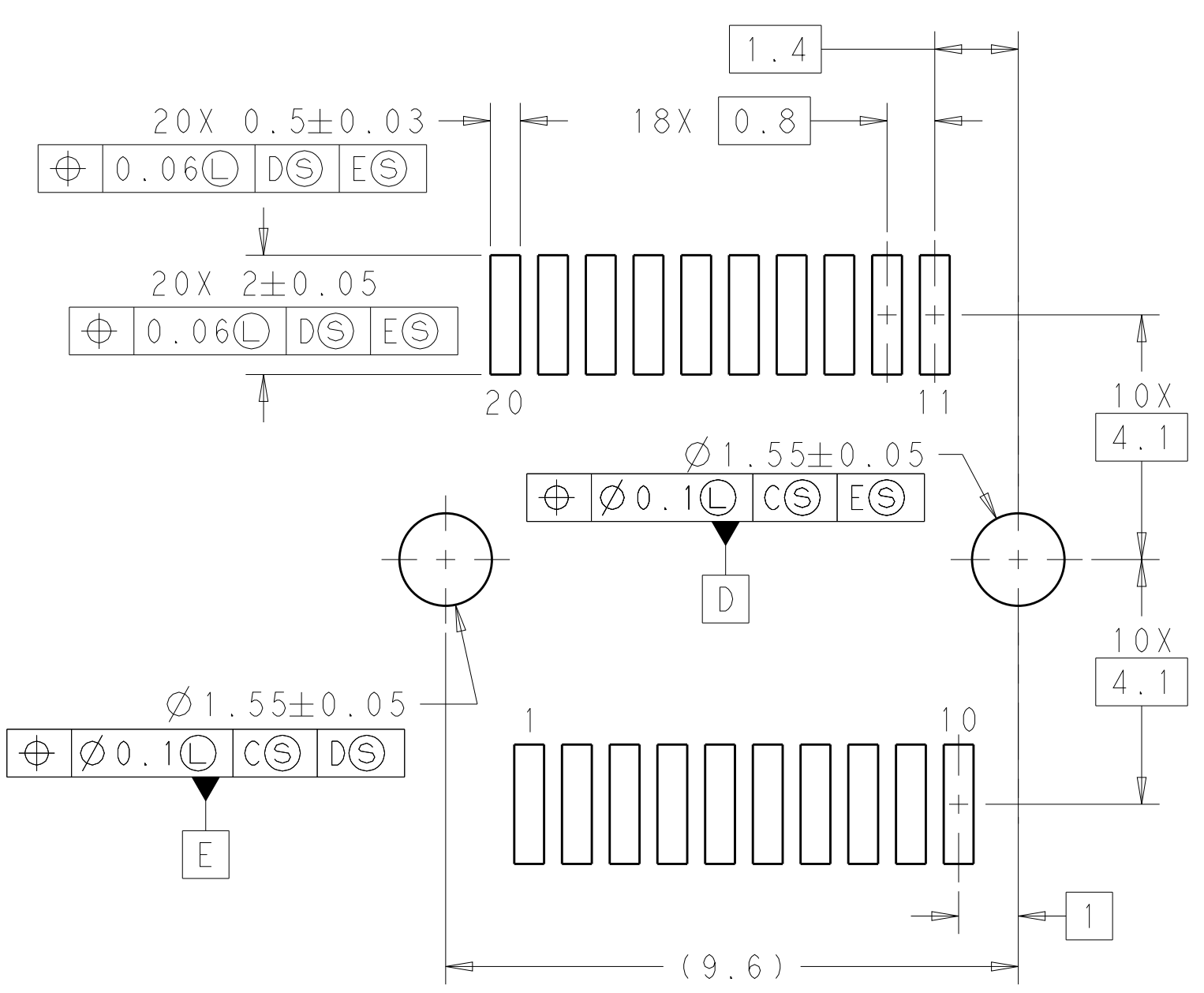
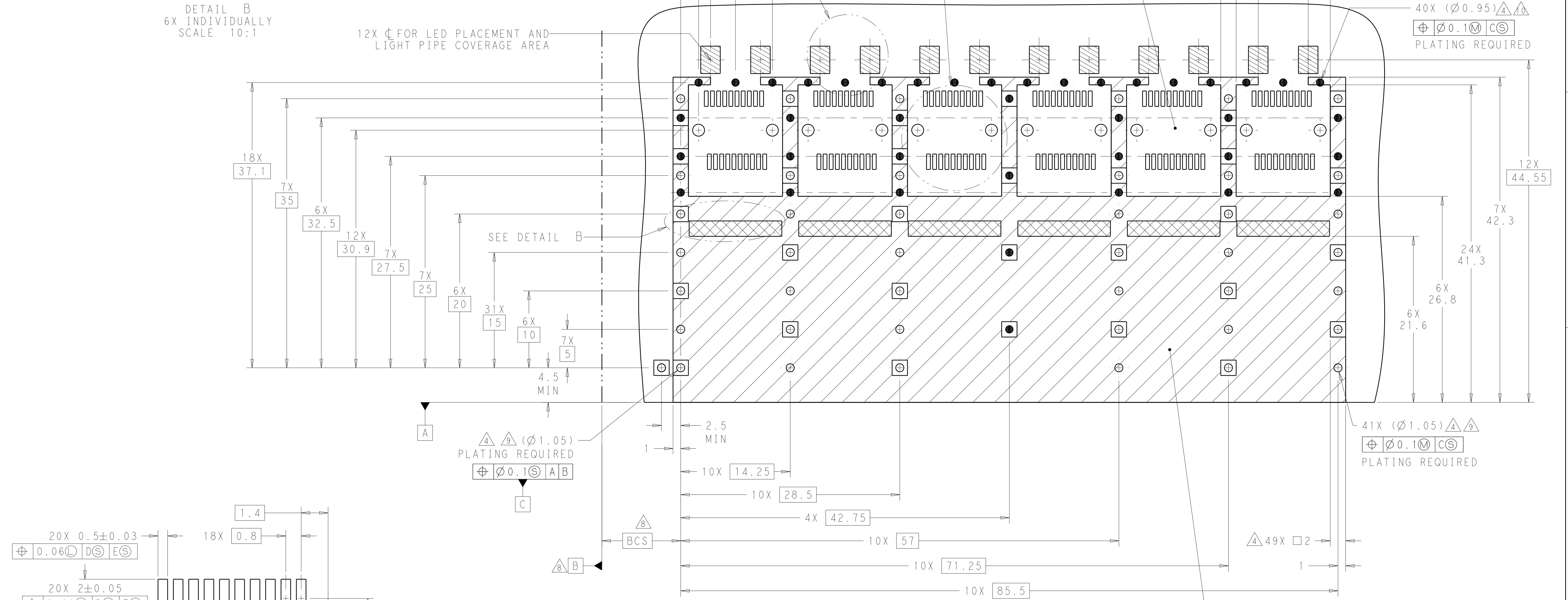
LOC	DIST	REV	DATE	BY	APPV
GP	00				

REVISIONS			
NO.	DESCRIPTION	DATE	BY
-	SEE SHEET 1	-	-

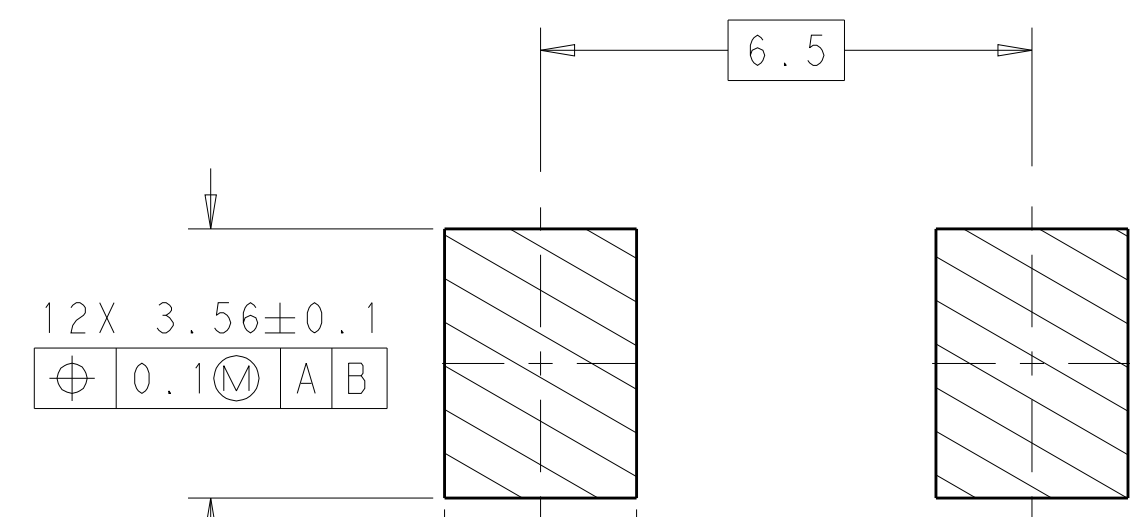


DETAIL B
6X INDIVIDUALLY
SCALE 10:1

12X ϕ FOR LED PLACEMENT AND LIGHT PIPE COVERAGE AREA



DETAIL Y
RECOMMENDED PT CONNECTOR LAYOUT
12X INDIVIDUALLY
SCALE 10:1



DETAIL Z
SCALE 10:1

RECOMMENDED PCB CONFIGURATION WITH KEEP-OUT AREAS BELLY TO BELLY APPLICATIONS SCALE 4:1

CROSS-HATCHED AREA DENOTES COMPONENT AND TRACE KEEP-OUT (EXCEPT CHASSIS GROUND)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B. MATTHEWS 15NOV2011 CHK M. SCHMITT 15NOV2011 APVD M. SCHMITT 15NOV2011	TE Connectivity
DIMENSIONS: mm 	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 0.1 1 PLC ± 0.1 2 PLC ± 0.1 3 PLC ± 0.1 4 PLC ± 0.1 ANGLES ± 0.1 FINISH ± 0.1	NAME: SFP+ ENHANCED 1X6 CAGE ASSEMBLY, PRESS FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS WITH HEATSINK AND LIGHTPIPE PRODUCT SPEC: 108-2364 APPLICATION SPEC: 114-13120 WEIGHT: - Customer Drawing	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.